

## SMT Single Pair Ethernet Steckverbinder, stehend, Einbau in Verbindung mit 661-4 SMT Single Pair Ethernet Connector, vertical, for assembly with 661-4

### Technische Daten / Technical Data

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Gehäuse                   | Messing vernickelt, Gummi, Mutter: Edelstahl      |
| Shell                     | Nickel plated brass, Rubber, Nut: Stainless steel |
| Isolierkörper             | Thermoplast, nach UL94 V-0                        |
| Insulator                 | Thermoplastic, rated UL94 V-0                     |
| Kontaktmaterial           | Kupferlegierung                                   |
| Contact Material          | Copper Alloy                                      |
| Kontaktoberfläche         | Gold über Nickel                                  |
| Contact Surface           | Gold plated over nickel                           |
| Oberfläche Lötanschluss   | Mattzinn über Nickel                              |
| Plating Solder Side       | Matte tin plated over nickel                      |
| RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c  | Gehäuse: 6c; Mutter: 6a                           |
| RoHS Exemptions 6a-I / 6c | Housing: 6c; Hex Nut: 6a                          |
| Isolationswiderstand      | > 500 MΩ                                          |
| Insulation Resistance     | > 500 MΩ                                          |
| Spannungsfestigkeit       | 1 kV DC                                           |
| Test Voltage              | 1 kV DC                                           |
| Nennspannung              | 72 V DC                                           |
| Voltage Rating            | 72 V DC                                           |
| Nennstrom                 | 4 A                                               |
| Current Rating            | 4 A                                               |
| Temperaturbereich         | -40 °C ... +85 °C                                 |
| Temperature Range         | -40 °C ... +85 °C                                 |
| Verarbeitung              | Reflow-Lötverfahren                               |
| Processing                | Reflow soldering                                  |



© W+P PRODUCTS

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s  
Data Transfer Ratio: 1 Gbit/s

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert       |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150°C          |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200°C          |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 120-150s       |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 230°C          |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60s max.       |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 1,5°C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260°C max.     |
| Dauer Höchsttemperatur               | 5-10s          |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 3°C / s        |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$  | Max. 4,5min    |

